증시 롤러코스터에 '피난'… 파킹형 상품으로 뭉칫돈 이동

파킹형 ETF 한 달 새 3.5조 순유입
MMF 설정액 270조 가까이 급증
주식·금값 변동성에 관망세 확산
머니마켓형 ETF 연 수익률 3%대
안정적 수익 좇아 대기자금 집중


ChatGPT로 생성된 이미지. 증시 불안에 대기자금이 파킹형 ETF로 돌아오고 있지만, 자금은 머니마켓형에만 몰리고 금리형은 외면받고 있다.

국내 증시의 '롤러코스터' 장세가 이어지면서 변동성을 피하려는 자금이 안전 추구형 금융상품으로 빠르게 이동하고 있다. 개별 종목은 물론 전통적 안전 자산으로 꼽히는 금 가격까지 큰 폭으로 출렁이자 투자자들이 머니마켓펀드(MMF)나 만기가 짧은 채권·기업어음에 투자하는 상장지수펀드(ETF) 등으로 눈을 돌리고 있는 것이다. 시장 불안이 커지면서 리스크는 낮으면서도 은행 예금보다 상대적으로 높은 수익을 기대할 수 있는 이른바 '파킹형 상품'으로 자금 이동이 두드러진다는 분석이 나온다.

◆연 3%대 파킹형 ETF로 대기자금 이동

2일 한국거래소에 따르면 국내 상장 원화 파킹형 ETF 31종에는 지난달 3조4839억원이 순유입됐다. 머니마켓·단기채형에 3조7547억원이 들어온 반면, 양도성예금증서(CD)·한국무위험지표금리(KOFR) 금리형에서는 2708억원이 빠져나갔다. 전체 유입액의 66%인 2조3127억원은 'KODEX 머니마켓액티브' 한 상품에 몰렸다. 이에 힘입어 31종의 순자산은 50조원을 넘어섰다.

파킹형 ETF는 상대적으로 안정적인 수익을 얻을 수 있는 안전 추구형 ETF로 꼽힌다. 가령 KODEX 머니마켓액티브와 RISE 머니마켓액티브는 단기채와 기업어음(CP) 등에 투자한다. 주가지수를 추종하는 다른 ETF에 비해 상대적으로 변동성이 작아 원금 지키기에 유리하다는 평가다. WON 전단채플러스액티브는 3개월 이내 우량 전자단기사채(STB)와 CP를 선별해 포트폴리오를 구성해 정기예금 대비 높은 수준의 이자 수익을 추구한다. 마찬가지로 투자 위험이 은행 예금 수준에 가깝게 낮아, 주식시장의 불확실성이 커질 때 수요가 급증하는 경향이 있다.

머니마켓형의 최근 1년 수익률(분배금 재투자 기준)은 평균 3.11%로 KOFR금리형(2.67%)을 웃돌았다. 투자자들의 관망 심리가 커지면서 예금보다 수익률은 높으면서 언제든지 사고팔 수 있는 금융상품으로 자금이 흘러들어 가는 셈이다. 다만 은행 예금과 달리 예금자보호 대상은 아니다.

박우열 신한투자증권 연구원은 "MMF가 유동성이 가장 좋은 최단기채이다 보니 변동성이 큰 시장에서 그쪽으로 자금이 많이 몰린 것 같다"고 봤다.

◆MMF에도 270조원 가까이 자금 몰려

이 같은 흐름은 ETF뿐 아니라 MMF 시장에도 나타난다. 금융투자협회에 따르면 지난달 29일 기준 국내 MMF 설정액은 269조5469억원으로, 9월 말(231조5771억원)보다 37조9698억원(16.4%) 늘었다. 특히 인공지능(AI) 거품 우려와 미국의 금리 인상, 유가 상승 등의 요인이 겹치면서 증가세가 가팔라졌다는 분석이다. MMF는 국고채·기업어음 등 만기 1년 이하의 단기 금융상품에 투자하는 펀드다. 예금보다는 약간 높은 이자 수익률을 기대할 수 있고, 수시 입출금이 가능하다.

이는 불확실한 시장 분위기 속 안전한 투자처로 자금이 이동한 결과란 게 전문가들 설명이다. 대표 안전 자산인 금마저 가격이 출렁이는 점도 안전 추구형 ETF와 MMF의 투자 수요를 부추긴 요인으로 꼽힌다. 30일(현지시간) 인베스팅닷컴에 따르면 금 현물 가격은 온스당 3875.44달러로 마감했다. 하루 새 3.63% 급락하며 지난 1월 29일 기록한 장중 사상 최고치(5595.46달러)보다 30% 넘게 떨어졌다.

운용업계 관계자는 "반도체주가 반등한 틈을 타 일단 수익을 확정하고 안전한 곳에서 다음 투자 기회를 기다리려는 수요가 나타나고 있다"고 전했다.

김대종 세종대 경영학부 교수는 "투자자들이 증시를 완전히 떠나기보다 관망하면서 대기자금을 운용하는 것으로 해석할 수 있다"며 "향후 증시의 방향성이 뚜렷해지면 다시 주식시장으로 자금이 유입될 가능성이 있다"고 말했다. /김아영 기자 aykim@metroseoul.co.kr

'AI 서버 투자 열풍'… 한·일 전자부품 증설 경쟁 가열

엔비디아, 기판 생산능력 2.5배 확대
삼성전기, MLCC 8793억원 공급계약
日 이비덴, 기판 생산능력 3배 확대
무라타도 MLCC 증설에 8.5조 투입


일본 기후현에 위치한 이비덴 오노 공장 전경. /이비덴

인공지능(AI) 서버 투자 확대가 반도체 연결과 전력 공급에 필요한 부품 수요를 끌어올리면서 한·일 전자부품업체들의 증설 경쟁이 본격화하고 있다.

2일 삼성전기와 엔비디아 등의 발표에 따르면 삼성전기는 지난달 엔비디아와 세종·부산사업장의 반도체 기판 생산시설을 확충하기로 한 데 이어 30일 8793억원 규모의 AI 서버용 적층세라믹콘덴서(MLCC) 공급계약을 공시했다. 같은 날 일본 무라타제작소도 MLCC 증설 계획을 발표했으며, 일본 이비덴은 하루 앞서 서버 중앙처리장치(CPU)용 기판 추가 투자를 결정했다.

서버 출하 증가와 반도체 고성능화가 투자 확대를 견인하고 있다. 삼성전기는 지난달 28일 실적발표에서 AI 서버용 그래픽처리장치(GPU)와 주문형 반도체(ASIC)에 필요한 MLCC 정전용량이 매년 두 배씩 증가하고 있다고 설명했다. 전압 변동을 줄이는 MLCC의 저장 용량을 높이면서 크기는 줄여야 하는 기술적 요구도 커지고 있다.

AI 추론과 에이전트 확산도 부품 수요를 끌어올리고 있다. 트렌드포스는 지난달 29일 CPU 수요 증가로 메인보드와 DDR5 메모리 모듈용 고용량 MLCC 수요가 확대되고 있다고 설명했다.

◆삼성전기·이비덴, 엔비디아 수요에 기판 증설

엔비디아는 삼성전기와 일본 이비덴, 대만 유니마이크론과의 협력을 통해 자사 제품용 기판 생산능력을 향후 3년간 현재의 2.5배로 늘릴 계획이다.

삼성전기는 지난달 21일 엔비디아와 공동 투자로 세종·부산사업장의 전용 생산시설을 확충하는 파트너십을 발표했다. 올해부터 다년간 연산용·네트워크용 기판을 공급하며, 공급물량은 연평균 두 자릿수 증가할 것으로 전망했다.

앞서 지난 9월에는 고객사의 투자금 지원과 중장기 물량 확보를 바탕으로 세종·베트남 기판 증설에 총 6조7800억원을 투자한다고 밝혔다. 세종 증설 설비는 2028년 9월 양산을 시작할 계획이다.

투자 대상인 플립칩 볼그리드어레이(FC-BGA)는 고성능 반도체와 메인보드를 연결하는 기판이다. 여러 칩을 하나의 패키지에 집적하면서 기판 면적과 회로층도 늘어나고 있다는 게 회사 측 설명이다.

고성능 기판 공급 확대에 힘입어 삼성전기의 3분기 패키지솔루션 매출은 전년 동기보다 58% 증가한 9390억원을 기록했다. MLCC 등을 담당하는 컴포넌트 사업 매출도 AI 데이터센터용 공급 증가로 36% 늘어난 1조8830억원을 기록했다.

일본 이비덴도 엔비디아의 선급금을 바탕으로 오노 공장의 생산능력을 현재의 세 배로 확대한다. 증설 설비는 2028년 1분기부터 가동할 예정이다.

이와 별도로 서버 CPU용 기판에 약 1510억엔(약 1조2800억원)을 추가 투자해 일본 기후현 가마 사업장과 해외 생산거점의 생산능력을 늘린다. 신규 설비는 2029년 4월 시작하는 사업연도부터 순차 가동할 계획이며, 회사는 지난달 30일 AI 추론과 에이전트 확산을 반영해 고성능 서버 CPU 수요 전망도 상향했다.

이밖에도 엔디비아는 대만 유니마이크론과도 생산능력 예약 계약을 맺고 KF 공장을 증설한다. 엔비디아는 증설분이 2027년 2분기부터 가동돼 이듬해 중반 최대 가동에 들어갈 것으로 전망했다.

◆MLCC도 대규모 투자… 日 무라타 8조 투입

이에 전력 공급용 부품에서도 공급계약과 증설이 확대되고 있다. 삼성전기의 AI 서버용 MLCC 공급계약 기간은 올해 12월 21일부터 내년 같은 날까지이며, 고객사명은 비공개다. 이번 계약을 포함해 올해 공시한 주요 부품 장기공급계약은 8건, 약 5조1800억원으로 MLCC 외에 반도체 기판 등의 계약도 포함됐다.

일본 무라타제작소는 올해 4월부터 2031년 3월까지 5년간 약 1조엔(약 8조5000억원)을 투입해 MLCC 생산능력을 확대한다. 이를 통해 2031년 3월 결산 기준 MLCC 연간 매출을 2026년 3월 결산 대비 두 배 이상으로 늘릴 방침이다.

무라타는 일본 오카야마현에 2028년 말 완공을 목표로 MLCC 생산동을 신설하고 태국에도 새 생산동을 건설한다. /구남영 기자 koogija_tea@

中 전기차 '24개월 개발' 공세… 韓 부품업계 속도전

HL만도, 개발 병렬화로 기간 단축
조향장치 8개월 만에 공동 개발
현대모비스, 검증 효율화 속도

중국 신흥 전기차업체들이 신차 개발 기간을 2년 안팎으로 단축하면서 국내 부품업계와 글로벌 완성차업체들이 개발 체계 전환과 현지 대응 강화에 속도를 내고 있다. 2일 업계에 따르면 HL만도는 중국 완성차업체들의 짧아진 개발 일정에 대응하기 위해 기존 순차형 개발 방식을 병렬형으로 전환했다. 설계와 검토 등 개발 업무를 단계별로 진행하던 방식에서 벗어나 동시에 수행할 수 있는 작업을 함께 추진하는 구조다.

HL만도는 중국 현지 업체와 전동식 조향장치(R-EPS)를 8개월 만에 공동 개발했다. 영업·연구·생산·품질·구매 조직이 참여한 스마트 댐핑 제어(SDC) 프로젝트는 14개월 만에 양산에 들어갔다. 중국 소프트웨어 개발조직인 'SW 랩 차이나'도 100명 이상으로 확대했다.

HL그룹은 2일 중국 지역 대표를 지낸 박영문 사장을 HL만도 신임 최고경영자(CEO) 겸 오토섹터장으로 선임했다. HL만도는 기존 제품·기능·지역의 3개 축으로 운영하던 조직을 지역·기능의 2개 축으로 단순화해 의사결정과 사업 실행 속도를 높일 방침이다.

현대모비스도 개발 검증 시간을 줄이기 위해 연구개발 체계를 개선하고 있다. 지난 4월 실제 주행 데이터를 시뮬레이터와 연동해 자율주행·첨단운전자보조시스템(ADAS) 제어장치를 반복 시험하는 평가검증 시스템을 구축했다. 최대 60대의 시뮬레이터를 병렬로 연결하면 1만 시간 분량의 검증을 일주일 만에 수행할 수 있다.

중국 현지 협력망도 확대하고 있다. 현대모비스는 지난달 14일 중국 상하이에서 현지 기업과 완성차업체, 투자기관 등 300여 명이 참석한 '모비스 모빌리티 데이'를 처음 개최했다.

로보틱스와 피지컬 AI 분야의 현지 기업을 발굴해 공동 또는 독자 기술 개발과 실증, 사업화로 이어지는 협력 체계를 구축할 계획이다.

맥킨지에 따르면 중국 신흥 전기차업체들은 플랫폼을 포함한 신차 개발을 약 24개월 만에 마치는 반면 다른 자동차업체들은 40~50개월 이상이 걸린다. 자체 개발 비중 확대와 부품 공용화, 공급사와의 조기 협업, 개발 단계별 업무를 동시에 진행하는 방식 등이 개발 기간 단축의 배경으로 꼽힌다.

글로벌 완성차업체들도 개발 기간 단축에 나섰다. 폭스바겐은 중국에서 개발한 전자 아키텍처의 적용 차종을 확대하고 있으며, 제너럴모터스(GM)는 AI와 가상검증을 활용해 신차 개발 기간을 기존 4~5년의 절반으로 줄일 계획이다.

박 CEO는 지난달 HL 공식 인터뷰에서 "차이나 스피드에 대응하는 진짜 경쟁력은 단순한 개발 속도가 아니라 조직 전체가 함께 판단하고 움직이는 속도와 소통의 밀도에 있다"고 말했다. /이승혁 기자 sh95@